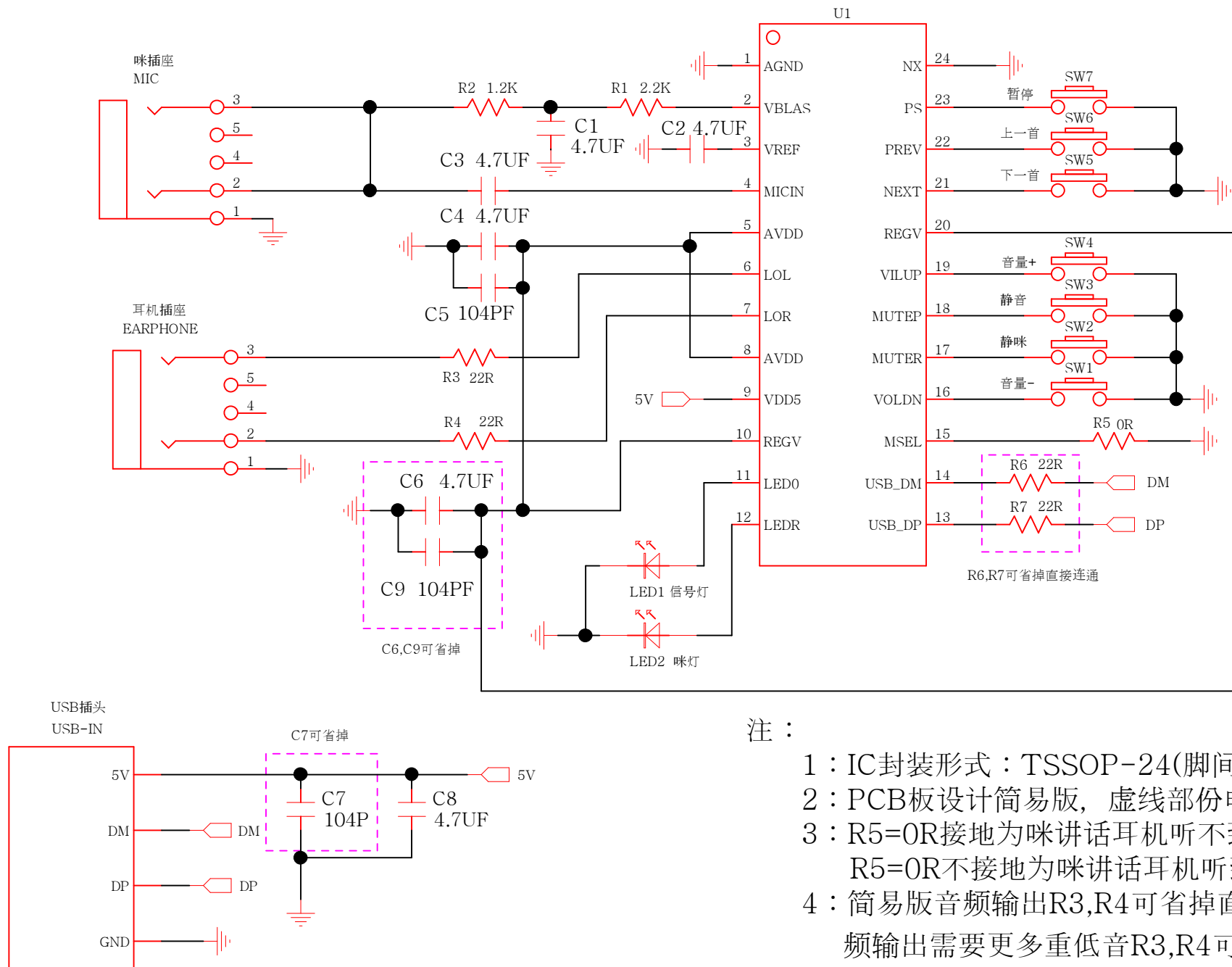




注：

- 1：IC封装形式：TSSOP-24(脚间距0.635MM)
- 2：PCB板设计简易版，虚线部份电子料可以省掉
- 3：R5=0R接地为咪讲话耳机听不到
R5=0R不接地为咪讲话耳机听到
- 4：简易版音频输出R3,R4可省掉直通，如果音频输出需要更多重低音R3,R4可改为100UF电解电容或100UF钽电容